

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2026-033

深圳市江波龙电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 419,145,267 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	江波龙	股票代码	301308
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	许刚翎	黄文芳	
办公地址	深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 2001、2201、2301	深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 2001、2201、2301	
传真	0755-86700940	0755-86700940	
电话	0755-86030009	0755-86030009	
电子信箱	ir@longsys.com	ir@longsys.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1) 主营业务

公司主要业务为存储器和主控芯片的研发设计、封装测试、技术支持与销售。公司通过覆盖芯片设计（主控芯片及

存储芯片)、固件算法开发、存储器设计、封装测试等存储关键环节的全栈式技术能力, 为市场提供消费级、企业级、车规级、工规级存储器以及行业存储软硬件应用解决方案。

公司产品的功能及主要应用

芯片产品	主要产品	功能介绍	主要应用
主控芯片	高性能主控芯片	负责存储器内部 NAND 闪存颗粒的数据管理, 并与 CPU 进行数据通信	端侧 AI 存储器、 高端存储器
	SPU 芯片	除 NAND 闪存颗粒的数据管理基础功能外, 还具备存内数据压缩和温冷数据智能调度能力, 可大幅提升大模型在端侧 AI 的部署能力	端侧 AI 存储器

存储芯片	SLC NAND 与 NOR 等特定型态存储芯片	作为存储器的高性能存储介质载体, 提供高可靠性支撑	高可靠性存储器
------	--------------------------	---------------------------	---------

存储器产品	主要产品	主要应用
-------	------	------

芯片级存储器	嵌入式存储	AI 手机、智能穿戴、智能汽车等
--------	-------	------------------

模组级存储器	固态硬盘	AI 服务器、AI PC、数据中心等
--------	------	--------------------

模组级存储器	移动存储	个人消费类存储、具身智能、智能汽车等
--------	------	--------------------

	内存条	AI 服务器、AI PC、数据中心等
--	-----	--------------------

公司拥有行业类存储品牌 FORESEE、海外行业类存储品牌 Zilia 和国际高端消费类存储品牌 Lexar (雷克沙)。公司产品广泛应用于端侧 AI 设备、AI 服务器、数据中心、汽车电子、物联网、安防监控、工业控制等领域, 以及个人消费类存储市场。

公司 FORESEE 品牌产品布局



公司 Lexar 品牌产品布局



(2) 主要产品

公司面向端侧 AI 设备、AI 服务器、数据中心、具身智能、汽车、价值消费类电子、工业（安防、监控等）等应用场景，为客户提供高性能、高品质、创新领先的半导体存储产品。目前，公司拥有自研芯片、嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条等产品线。

1、芯片产品

(1) 主控芯片

主控芯片是存储器的核心器件，其与配套固件算法一起，负责 NAND 闪存颗粒的数据管理，以及与 CPU 进行数据通信，实现数据管理、坏块管理、数据纠错、寿命均衡、垃圾回收等功能，直接关系到存储器的性能、可靠性和稳定性。进入 AI 大模型时代，“内存墙”的物理限制与高昂的内存成本，已成为大模型在端侧 AI 广泛应用的重要阻碍。在公司与产业生态伙伴共同推动下，主控芯片的系统定位正经历深刻重塑，从数据读写控制单元，演进为弥合算力与内存物理落差的智能中枢。

基于前瞻性的技术布局，截至本报告发布之日，公司已正式发布自研 HLC 技术（High Level Cache，高级缓存技术）。该技术通过主控芯片、固件算法与系统级架构的深度协同创新，让 SSD 或 UFS 存储设备承接原本由 DRAM 负责的温冷数据缓存工作，同时将高度依赖 DRAM 的缓存负载精准卸载至 NAND 中，保证数据访问的流畅性，并实现“NAND 对 DRAM 的无缝延伸”。HLC 技术从底层逻辑上，打破了制约大模型在端侧 AI 落地的内存瓶颈，公司已在紫光展锐、AMD 平台完成了联合调优，HLC 技术展现出优异的跨平台通用性与多场景落地能力。

截至本报告发布之日，公司已推出采用同等先进制程的 SPU（Storage Processing Unit，存储处理单元）芯片，该芯片集成存储控制引擎与智能处理引擎，适配 HLC 技术。根据公司内部测试，SPU 芯片的 NAND I/O 可达 4800MT/s，远高于市场采用 6-12nm 制程的部分 PCIe 5.0 SSD 主控芯片，支持 128TB 的 SSD 单盘最大容量，远高于市场主流消费级 SSD 的 8TB 最大容量。此外，SPU 芯片搭配专为端侧 AI 推理场景打造的存储智能调度引擎 iSA（Intelligence Storage Agent，存储智能体），能够大幅提升端侧 AI 大模型的模型规模上限。基于与 AMD 的联合调优，在 AI 移动工作站及 AI PC 平台的测试数据显示，搭载公司 SPU 与 iSA 的设备，相比传统存储方案，AI PC 端模型规模提高约 3.2 倍，内存利用效率提升约 200%，这一技术将为 AI PC 在普通个人用户的大规模推广奠定重要的存储技术底座。

在嵌入式存储的 HLC 技术应用上，公司依托自研 UFS 主控与紫光展锐联合开发，在紫光展锐平台的实测数据显示，4GB DDR 搭载 HLC 技术后，终端响应时间接近 6GB/8GB DDR 正常配置水平，在保障端侧 AI 设备体验和器件使用寿命的前提下，能够大幅优化终端 DRAM 容量需求，降低 BOM 成本。

在高端主控芯片领域，公司实现了 UFS 4.1、UFS 3.1、UFS 2.2 等多款主控芯片及关键核心技术的突破。就 UFS 4.1 主控芯片而言，全球仅有包括存储晶圆原厂在内的少数企业具备该款主控芯片的设计能力，而公司推出的 UFS 4.1 主控芯片进一步采用领先于产业主流的 5nm 制程工艺，搭载该主控芯片的 UFS4.1 产品整体性能优于市场可比产品，将从 2026 年开始实现规模化量产应用。

公司主控芯片的主要应用情况

产品型号	主要应用
WM8500	SPU 芯片，支持 PCIe 5.0 标准，NAND I/O 达 4800MT/s，已适配 HLC 技术，具备存内压缩、温冷数据智能调度能力，支持混合存储介质（hybrid）
WM7400	支持 UFS 4.1 标准，顺序读写性能达 4350MB/s 及 4200MB/s，随机读写性能达 700K IOPS 及 750K IOPS，支持 hybrid

WM7300	支持 UFS 3.1 标准，顺序读写性能达 2100MB/s 及 2100MB/s，随机读写性能达 480K IOPS 及 465K IOPS，支持 hybrid
WM7200	支持 UFS 2.2 标准，已适配 HLC 技术，顺序读写性能达 1070MB/s 及 1000MB/s，随机读写性能达 240K IOPS 及 210K IOPS
WM6000	支持 eMMC 5.1 标准，顺序读写性能达 345MB/s 和 310MB/s，随机读写速度达 220MB/s 和 190MB/s
WM5000	支持 SD 6.1 标准，顺序读写性能达 255MB/s 和 230MB/s
WM3000	支持 USB 3.2 Gen1 标准，顺序读写性能达 465MB/S 和 450MB/S

注：数据来源于公司内部实验，实际性能表现因设备配置、使用不同存在差异

(2) 特定型态存储芯片

SLC NAND Flash、NOR Flash 等特定型态的存储芯片，适用于高可靠性存储应用，如网络通信设备、安防监控系统、物联网设备及便携消费电子产品。公司自研存储芯片在生产过程中采用端到端质量管理，实现芯片级别的可追溯性及卓越的产品可靠性，DPPM 低于 100。公司已成功开发 512Mb 到 8Gb 之间的五款 SLC NAND Flash 存储芯片，并积极扩展至其他存储芯片产品线。公司存储芯片研发精准定位长尾市场，通过自研核心技术抢占高可靠性存储细分赛道，与晶圆原厂形成错位竞争。公司构建的从存储芯片设计到存储器的全链条能力，为后续拓展更广泛的存储产品线及进入更高门槛市场奠定了坚实基础。

2、嵌入式存储

(1) UFS、eMMC

UFS、eMMC 是应用于智能手机、智能穿戴设备、平板电脑等领域的大容量 NAND Flash 嵌入式存储器，特别是作为智能手机的存储模块被广泛使用，是半导体存储的核心产品类别之一。

公司持续保持自研主控与自研固件的技术优势，对 UFS 标准的嵌入式存储器持续投入研发。基于自研 UFS 4.1 主控芯片，公司 UFS 4.1 产品的多项性能超越市场同类产品，并支持在 UFS 中同时使用混合存储介质 (hybrid)，能够有效的平衡 TLC 和 QLC 介质各自的特点。公司正有序提升自身的各类 UFS 产品，特别是搭载公司自研主控芯片的 UFS 存储器在公司整体嵌入式业务中的占比，力求在从 eMMC 向 UFS 过渡的关键时期，稳固并持续保持自身在市场中的领先地位。截至本报告发布之日，公司已与包括闪迪在内的多家晶圆原厂，以及多家头部智能手机厂商达成了 UFS 4.1 的合作，以 UFS 4.1 为代表的旗舰存储产品已经全面进入规模化出货阶段，进一步扩大公司在超高端存储领域的领先地位。

作为成熟可靠的存储产品，eMMC 在对性能稳定性有较高要求、同时又注重成本效益的应用场景中，仍然占据着大量的市场份额。公司依托自研 eMMC 主控芯片与固件技术，于 2024 年率先实现 QLC eMMC 产品的量产出货，是全球极少数具备 QLC eMMC 量产能力的企业。该产品在读写性能上对标主流 TLC eMMC，同时凭借更大的容量和更具竞争力的成本优势，能够有效替代传统 TLC eMMC 解决方案。目前，该产品已成功应用于知名品牌厂商的多款终端产品，为公司巩固 eMMC 市场的领先地位注入了新的增长动能。

公司的自研主控芯片经过严格测试和验证，具备高性能、高可靠性和低功耗等特点，能够满足智能汽车在不同场景下的复杂需求。车规级 eMMC 全芯定制版本已搭载自研主控芯片，容量最高可达 128GB，符合 AEC-Q100 Grade2/3 标准，覆盖宽温域，适配中轻量级智能汽车场景，在 2025 年实现多个客户的规模化量产。车规级 UFS 系列实现 UFS4.1 至 UFS2.2 全协议覆盖，最高可达 512GB，读写性能优势显著，适配智能座舱、ADAS 域控制器等应用，未来将逐步搭载自研高性能主控芯片，为新一代智能汽车提供存储升级路径。

（2）超小尺寸 eMMC、ePOP

超小尺寸 eMMC 及 ePOP 主要是面向尺寸受限的穿戴类产品应用场景，开发的小尺寸及高集成嵌入式存储器；ePOP 将存储芯片贴片于 CPU 表面以减少印刷电路板面积占用，适用于智能 AI/AR 眼镜、智能手表、智能手环、耳机等可穿戴设备。

公司已经推出了超薄 ePOP4x 及超小尺寸 eMMC，产品采用创新的研磨切割工艺，由公司旗下元成苏州自主封测，产品尺寸上显著小于市场主流产品。超薄 ePOP4x 将 eMMC 闪存与 LPDDR4x 内存“合二为一”，其最大厚度仅为 0.6mm，相比上一代 0.8mm 厚度产品减少了近 25%；超小尺寸 eMMC 面积比标准 eMMC 减少了约 65%，极大提升了设备的便携性。公司超小尺寸 eMMC 及 ePOP 精准匹配 AI 穿戴设备对存储小型化与高性能的双重需求，目前已应用于众多国际国内头部厂商的智能眼镜、智能手表当中，助力公司抢占智能穿戴领域的 AI 增量市场。

公司在 CES 2026、MWC 2026 上正式发布面向 AI 智能穿戴、轻薄便携终端的新一代集成存储产品 ePOP5x，为公司在端侧 AI 存储领域的前瞻性战略布局。ePOP5x 由公司旗下元成苏州自主封测，在保持与上一代 ePOP4x 相同 8mm×9.5mm 标准尺寸的前提下，封装厚度继续缩减，最薄可以做到仅 0.52mm。根据公司内部测试，ePOP5x 的 DRAM 传输速率高达 8533Mbps，较上代提升 100%，可高效支撑 AI/AR 智能眼镜、智能手表等设备的端侧 AI 应用、多任务并发与高速数据交互。产品支持 64GB+16Gb、64GB+24Gb、64GB+32Gb 等多容量组合配置，具备低功耗、高集成、高可靠性等特性，精准匹配下一代穿戴设备对轻薄化、高性能、长续航的核心需求。ePOP5x 已进入方案适配、客户验证、性能验证与市场导入阶段。

（3）LPDDR

LPDDR 是低功耗的 DRAM 存储器，主要应用于智能手机、平板电脑等功耗限制严格的消费电子产品。公司 LPDDR 产品的容量覆盖 8Gb 到 128Gb，作业温域为-25℃~85℃，已获得高通、AMD、联发科（Media Tek，MTK）、紫光展锐、Amlogic 等平台认证，基于领先的存储芯片测试能力和品控能力，在智能手机、平板电脑、机顶盒、车载导航等领域获得行业优质客户青睐。公司紧跟 LPDDR 应用市场的脚步，在 LPDDR4X 供应紧张的情况下仍力争更好地服务客户，LPDDR5/5X 产品也已经大面积量产并成为交付主力，为后续 LPDDR6 新品开发做好相应准备。公司未来在嵌入式存储市场将继续保持领先，实现更多突破。

公司车规级 LPDDR4 已通过车规测试标准体系 AEC-Q100 认证，可实现最低-40℃、最高+105℃的宽温域作业，LPDDR4 产品已在多个汽车客户完成产品验证，并开始量产出货。

3、固态硬盘（SSD）

固态硬盘（SSD）是按照 JEDEC 有关接口标准制造的大容量 NAND Flash 存储器。公司产品覆盖 SATA 和 PCIe 两大主流接口，应用于服务器、笔记本、台式机、一体机、视频监控、网络终端等领域，公司近年来持续拓展企业级和高端消费级 SSD 市场。

公司已经推出了多款高速企业级 eSSD 产品，覆盖 480GB 至 7.68TB 的主流容量范围，支持 1DWPD（每日整盘写入次数）和 3DWPD 的耐用性选项，产品外形涵盖 2.5 英寸到 M.2 的多种规格。企业级 PCIe SSD 具备多档功耗调节、无感在线固件升级、多命名空间以及可变 Sector Size 等先进功能，通过支持 Telemetry、Sanitize、Raid、全路径端到端数据保护等企业级特性，提升数据存储的安全性和可靠性。公司的企业级 PCIe SSD 与企业级 SATA SSD 两大产品系列已成功完成与鲲鹏、海光、龙芯、飞腾、兆芯、申威多个国产 CPU 平台服务器的兼容性适配，为在主流平台上的广泛应用提供了坚实的技术基础。

针对高端 OEM 市场，公司创新推出了全新的 mSSD（Micro SSD）产品，通过 SIP（System in Package）封装技术让 SSD 达到芯片级封装质量，不仅能够实现高效交付，还能灵活兼容 M.2 2280、2242 及 2230 等主流规格，已赢得多家 AI PC 客户的深度认可及项目导入。为攻克小体积、高性能的散热痛点，公司将 VC 相变液冷散热应用在 mSSD 上，设计出专属高效散热方案，根据公司内部测试，PCIe Gen5 mSSD 的高效散热方案将 11GB/s 峰值性能维持时间提升至 181 秒，连续读取容量可达 1991GB，是常规 PCBA SSD 散热方案的近 2.5 倍。随着端侧 AI 需求的全面爆发，mSSD 高度契合了 AI PC 对极致性能与紧凑形态的苛刻要求，公司也在积极将其向具身智能等高端应用场景拓展，提供高抗震/高可靠性的存储解决方案。

消费类 SSD 上，Lexar 已推出 NM1090 PRO 和 ARES PRO 两款高端 M.2 PCIe5.0 NVMe SSD 产品，根据公司内部测试，读取速度高达 14000MB/s，是 PCIe4.0 产品约 2 倍速度；Lexar 已推出 THOR PRO M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe 固态硬盘，读取速度高达 7000MB/s，通过优化数据传输速率和系统响应速度，能够大幅缩短等待时间。

4、内存条

公司内存条产品线覆盖 DDR4 及 DDR5 系列规格，涵盖消费级、工业级、企业级内存条，产品容量从 4GB 到 256GB，广泛应用于个人电脑、教育/金融智能系统、银行/医院自助终端、网络终端、大型会议中心、安防监控、交通/通讯、小型工作站、工业自动化、电竞等多个应用领域。

在企业级存储领域，公司已推出最大容量为 256GB 的 DDR5 RDIMM 产品，企业级 DDR5 内存条涵盖从 16GB 至 256GB 主流全容量系列，完成了 AMD Threadripper PRO 9000WX 系列兼容性认证，加深了与 AMD 和 Intel AVL 官方认证合作，并在国产鲲鹏、海光、飞腾等多个国产 CPU 平台实现服务器兼容性验证，适用于电信、金融、互联网等各类场景。针对目前 AI 加速落地情况，公司积极抓住存储行业新的发展趋势，已点亮 SOCAMM 产品，结合 MRDIMM、LPCAMM2、CAMM2、CXL2.0 内存拓展模块补齐未来产品版图，提供持续的服务客户能力。

公司 SOCAMM 产品采用 LPDDR5X 技术，提供 128 位 I/O 位宽，并集成存储控制器与内存单元，根据公司内部评

估数据，SOCAMM 的带宽、延迟、功耗显著优于 DDR5 RDIMM，能大幅加速 AI 训练和推理任务的数据吞吐。公司 SOCAMM 产品支持高密度服务器部署，单模块可达 128GB，满足大模型训练需求，依托于 LPDDR5X 的低电压特性，SOCAMM 产品将显著降低数据中心能耗，并结合近 CPU 布局，全面突破传统 RDIMM 的带宽、延迟瓶颈及高温痛点。基于 SOCAMM 的明显优势，相关产品在未来 AI 服务器及 AI 的应用上有望得到广泛的应用。

公司完成了 8800/12800 系列的 MRDIMM 产品开发验证，可以实现最高至 256GB MRDIMM 产品。根据行业数据，MRDIMM 多路复用的特性可以提升产品约 2 倍理论带宽，并有效降低约 40% 延迟，具备无需更改主板兼容 RDIMM 产品的良好兼容性，能有效降低数据中心 TCO 成本。在未来 AI 需求持续增长的市场环境下，MRDIMM 将会越来越多扩宽到 AI 训练/推理、HPC、内存数据库、大数据分析、高频交易等带宽与延迟敏感场景。

消费类内存条产品上，Lexar 推出 ARES RGB DDR5 战神之刃二代，采用高频率 6800MT/s，支持 RGB 光效设计，用户可以通过 Lexar Sync 软件自定义灯光效果。根据灼识咨询资料，Lexar ARES RGB DDR5 台式机内存系列是市场上速度最快的 DDR5 产品之一。

5、移动存储

移动存储指 USB 闪存盘、存储卡及便携式移动固态硬盘等便携式移动存储器，主要应用于安防监控、车载应用、高清摄影、智能终端、游戏应用等领域。

公司在移动存储产品线已经推出多款移动产品，为 ODM/OEM 客户提供更多更好新产品、新解决方案选择：在 USB 产品线上，公司已成功推出基于自研主控的车载数据备份盘，用于行车记录以及哨兵模式，满足车辆环境对电磁干扰（EMI）防护及宽工作温域等严苛要求，产品相较于行业主流产品，读取速度高约 20%，功耗低约 40%，广泛应用于国内外多家知名新能源品牌；在 SD Express 产品线上，公司已推出全新高性能 SD Express 产品，读速最高可达 880MB/s，容量涵盖 256GB 至 1TB，已被高端游戏、高清摄像应用领域采用；公司还推出了多款移动固态硬盘（PSSD）产品，读写性能最高达到 2000MB/s，全局写性能达到 1GB/s，实现三防、AES 等级加密等各定制化需求。

公司旗下国际高端消费类存储品牌 Lexar 推出多款移动存储旗舰产品。在 PSSD 领域，Lexar 发布了 NFC 加密移动固态硬盘，搭载江波龙自研主控芯片，将 NFC 加密技术融入移动固态硬盘之中，通过 NFC 协议，可与用户手机等设备实现唯一配对，全方位守护用户隐私数据安全；Lexar 发布了 ES5 磁吸移动固态硬盘，读取速度最高达 2000MB/s，支持高写速拍摄 4K 120fps，可以通过磁吸在手机背面，方便用户单手操作手机。在存储卡领域，Lexar 推出了 PLAY PRO microSDXC Express 存储卡，采用全新的 microExpress 存储标准，以及 PCIe 和 NVMe 接口协议，读取速度最高可达 900MB/s，写入速度最高可达 600MB/s，最高容量达 1TB；Lexar 推出了 Blue microSDXC UHSI 存储卡，读取速度最高可达 160MB/s，支持 4K 视频传输，提供 2TB 级别的最大容量。

注：移动存储部分产品性能数据来源于公司内部实验，实际性能表现因设备配置、使用不同存在差异。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产	22,750,717,517.80	16,896,667,412.13	34.65%	13,679,845,767.45
归属于上市公司股东的净资产	7,854,293,966.70	6,467,489,442.63	21.44%	6,021,129,105.70
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	22,766,169,990.55	17,463,650,272.14	30.36%	10,125,111,900.80
归属于上市公司股东的净利润	1,423,298,162.88	498,684,535.69	185.41%	-827,809,358.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,289,178,618.90	166,542,635.13	674.08%	-882,103,741.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,201,201,037.10	-1,189,741,403.84	-0.96%	-2,798,399,823.91
基本每股收益（元/股）	3.41	1.2	184.17%	-2.01
稀释每股收益（元/股）	3.38	1.2	181.67%	-2.01
加权平均净资产收益率	19.41%	7.92%	11.49%	-13.01%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,256,456,756.59	5,939,198,613.60	6,538,676,585.38	6,031,838,034.98
归属于上市公司股东的净利润	-151,814,511.52	166,580,773.60	697,866,792.03	710,665,108.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-202,041,574.57	234,248,486.70	446,566,687.45	810,405,019.32
经营活动产生的现金流量净额	153,033,415.95	539,866,979.38	229,395,683.01	-2,123,497,115.44

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	80,056	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	89,679	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
蔡华波	境内自然人	38.67%	162,071,900.00	121,553,925.00	不适用	0.00			
李志雄	境内自然人	4.51%	18,908,548.00	17,325,000.00	不适用	0.00			
宁波龙熹一号自有资金投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.18%	17,516,047.00	0.00	不适用	0.00			
宁波龙乙自有资金投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.18%	17,516,047.00	0.00	不适用	0.00			
宁波龙熹三号自有资金投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.92%	16,410,859.00	0.00	不适用	0.00			
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	3.82%	16,008,493.00	0.00	不适用	0.00			
蔡丽江	境内自然人	3.51%	14,700,000.00	0.00	不适用	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.15%	13,189,735.00	0.00	不适用	0.00			
宁波龙舰自有资金投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.57%	6,575,485.00	0.00	不适用	0.00			
宁波龙熹五号自有资金投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	5,801,905.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人蔡华波与蔡丽江系姐弟关系，于 2021 年 8 月 9 日签署一致行动协议，明确约定在双方意见不统一时以蔡华波意见为准，不存在影响实际控制权稳定性的风险因素。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。								

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

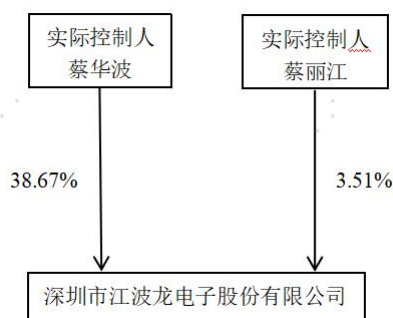
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

(一) 公司增选第三届董事会独立董事

为满足国际化发展的需要，进一步加强公司治理水平，保证公司董事会工作的有序开展，公司于 2024 年 12 月 18 日、2025 年 1 月 3 日分别召开了第三届董事会第六次会议以及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司增选第三届董事会独立董事的议案》，经公司第三届董事会提名委员会任职资格审核通过，公司选举邓美珊女士为公司第三届董事会独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日、2025 年 1 月 3 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(二) 计提信用减值损失及资产减值损失

2025 年度，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31 日的各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等各类资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值损失。2025 年 1-12 月，公司对应收账款计提减值损失为 74.93 万元，计提存货跌价损失金额为 31,366.06 万元。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(三) 利润分配

公司于 2025 年 3 月 19 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为保障

公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度、2026 年第一次中期利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年其他中期分红方案的议案》，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以截至公司现有总股本 419,145,267 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），共分配现金股利 146,700,843.45 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司拟定 2026 年第一次中期分红预案为：以公司 2026 年 3 月 31 日的总股本 419,145,267 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.50 元（含税），合计拟派发现金股利人民币 272,444,423.55 元（含税）。若利润分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（四）公司筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项

为进一步深化公司战略发展目标，经充分研究论证，公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市。公司已于 2025 年 3 月 21 日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H 股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请材料。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在巨潮资讯网披露的相关公告。公司于 2025 年 9 月 15 日披露了《关于发行境外上市外资股（H 股）获得中国证监会备案的公告》，公司收到中国证监会出具的《关于深圳市江波龙电子股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函（2025）1559 号），公司本次发行并上市获得中国证监会备案通过。

（五）续聘会计师事务所

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（六）股东减持股份

报告期内，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司，公司员工持股平台宁波龙熹一号自有资金投资合伙企业（有限合伙）、宁波龙乙自有资金投资合伙企业（有限合伙）、宁波龙熹三号自有资金投资合伙企业（有限合伙）、宁波龙舰自有资金投资合伙企业（有限合伙）、宁波龙熹五号自有资金投资合伙企业（有限合伙），公司董事李志雄先生、副总经理朱宇先生、副总经理高喜春先生等，均严格遵守相关法律法规要求，先后有序完成了相应的公司股份减持计划。公司就前述减持计划发布了预披露公告，并及时披露减持进展公告，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日、2025 年 7 月 9 日、2025 年 7 月 23 日、2025 年 8 月 11 日、2025 年 8 月 20 日、2025 年 9 月 18 日、2025 年 9 月 23 日、2025 年 10 月 31 日、2025 年 11 月 12 日、2025 年 11 月 27 日、2025 年 12 月 3 日、2025 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露

的相关公告。

（七）选举第三届董事会职工代表董事

公司于 2025 年 12 月 29 日召开职工代表会议选举第三届董事会职工代表董事，经全体与会职工代表表决通过，同意选举李志雄先生为公司第三届董事会职工代表董事。任期自本次职工代表会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（八）聘任公司财务负责人

因分管工作调整的原因，朱宇先生申请辞去公司财务负责人职务。辞任后，朱宇先生仍担任公司副总经理且任期不变。公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任黎玉华女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（九）2025 年度向特定对象发行 A 股股票

公司于 2025 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议、于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第四次股东会审议通过 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项等议案，具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 3 日、2025 年 12 月 22 日在巨潮资讯网披露的相关公告。公司于 2026 年 1 月 8 日收到深交所出具的《关于受理深圳市江波龙电子股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕4 号）。深交所根据相关规定对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（十）购买控股子公司少数股东股权

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟购买控股子公司少数股东股权的议案》，公司拟通过全资子公司 Lexar Europe B.V.以自有及/或自筹现金 4,608 万美元购买目前持股 81%的控股子公司 Zilia Eletrônicos 剩余少数股东持有的 19%股权。2026 年 3 月 31 日，本次交易交割条件均已满足，本次交易的交割工作已经依约完成，Zilia Eletrônicos 已成为公司 100%全资子公司。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（十一）员工购房借款

公司于 2023 年 3 月 20 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司为员工提供购房借款并制定〈员工购房借款管理办法〉的议案》。在不影响公司主营业务发展的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 10,000 万元的自有资金为符合条件的员工提供购房借款，在此限额内资金额度可以循环使用，并进一步制定了《员工购房借款管理办法》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在巨潮资讯网披露的相关公告。截至 2025 年 12 月 31 日，公司向员工提供购房借款的本金余额为 2,193.27 万元。